

SG501 导热硅脂

简介

随着电子元器件的微型化，放热器件需要有很好的导热介质使产生的热量有效地传到环境中，从而避免电子元件过热而造成产品性能和寿命的问题。SG501 是应用于电子器件组装中的导热硅脂。它良好的导热性和优异的界面接触可以使热传导通畅。同时，SG501 具有低油离和适宜的了流变性，即保障产品长期的导热效果又方便使用。

产品性能概况

性能	单位（测试条件）	SG501
颜色		白
表象		膏状
组分		单组分
粘度	mPa.s (25 °C)	稍流淌
密度	g/ml (25 °C)	2.12
热导率	W/mK	1.0
最大颗粒	Micron	25
挥发成分	%	<1
油离度 (120 °C /24 hr)	%	<0.1
体积电阻率	Ω .cm	10^{16}
老化 (150 °C/24 hr)		无变化
环保测试	RoHS	通过

使用说明

1. 所有的基材表面必须干净和干燥。
2. 将膏状硅脂涂在电子器件或散热器的平面上。
3. 将电子器件与散热器的平面压紧，使导热硅脂在两个平面之间形成非常薄的界面。
4. 将散热器加固。

使用注意事项

- A. 导热硅脂接触的电子器件和散热器的平面要尽量平整。
- B. 如果硅脂在容器内有表面浮油，可以通过搅动把油混入硅脂中。
- C. 尽量避免过多气泡夹杂于硅脂中。
- D. 加固散热器的力度要适当平衡，以确保导热硅脂界面厚度均匀。

储存与产品保质期

SG501 可以存储在室温下 24 个月。

安全

请参考本产品，或类似产品的 MSDS。

告用户

本文中的资料是依据我们现有知识的真实表示。欧赛尔（苏州）新材料有限公司保证该产品符合其销售规格。本产品资料决不能在进行必需的测试前作为替代品时使用，该测试是唯一能保证某产品适合于指定的用途。用户应负责保证遵守当地法规并获得必需的证书和认可。用户应复核他们拥有的该产品的资料是最新的版本，欧赛尔（苏州）新材料有限公司可按他们的要求来提供任何附加的资料。

欧赛尔（苏州）新材料有限公司